

证券代码：600330

证券简称：天通股份

天通控股股份有限公司  
投资者关系活动记录表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 参与单位名<br>称及人员         | 华福证券有限责任公司吴泽良、卢大炜，博裕资本投资管理有限公司姜涵奕，致合（杭州）资产管理有限公司张珂畅、张创（以上排名不分先后）                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间                    | 2025 年 9 月 22 日 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 地点                    | 海宁公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 公司接待人<br>员            | 董事长：郑晓彬<br>董秘：冯燕青<br>投资者关系管理：姚天恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系<br>活动主要<br>内容介绍 | <p>一、公司发展介绍</p> <p>天通股份是一家专注于电子材料和智能装备领域协同发展的公司, 在材料开发和客户优势、材料与装备产业协同优势以及产业投资与生态圈建设方面具有较强的核心竞争力。根据行业环境的变化，现阶段公司业务重心将逐步侧重于电子材料业务板块，智能装备将主要定位为为公司电子材料板块提供支撑和辅助。</p> <p>二、问答：</p> <p>1、公司压电晶体材料主要应用方向在哪里？主要竞争对手有哪些？主要客户有哪些？不同尺寸的压电材料应用方向有何差异？该业务发展潜力如何？</p> <p>压电晶体材料主要应用方向包括声学的声表面滤波器和光学调制调节器等。竞争对手主要是日本等海外厂商，国内也有部分厂商，但体量都比较小。目前压电晶体材料主流应用量产尺寸为 4</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>寸、6 寸。此外，目前正在做产品验证 12 寸是未来潜在的增长点，主要将应用在 AR 眼镜显示镜片上。当然目前 AR 眼镜还有其他的技术路线，包括碳化硅、高折玻璃等。压电晶体材料目前凭借其优异的压电和光电性能在数据中心、AR 眼镜等多领域有应用可能。铌酸锂材料在 1.6T、3.2T 光模块应用领域的趋势已经明确。</p> <p><b>2、公司的铌酸锂晶体毛利率如何？在光模块中的成本占比是多少？</b></p> <p>毛利率在不同的应用领域有所不同，但预估均在 30%以上。据产业链调研数据，铌酸锂晶体在光模块中的成本占比约为 25%-35%。</p> <p><b>3、公司软磁材料板块一体电感业务发展如何？今年该业务板块的展望如何？应用领域布局有何侧重？</b></p> <p>一体电感产品主要在服务器电源模块中应用，目前主要也是和国内前列的服务器厂商在合作，业务规模在千万级别，2025 年预估产值在 5000 万元左右。软磁材料业务板块目前有 40%左右在电动汽车领域，但逐步将走向稳定，下一个重要的应用领域预计在人工智能领域。</p> <p><b>4、公司蓝宝石业务板块是否复苏？是否有新的业务应用方向？</b></p> <p>蓝宝石业务经过长时间的底部徘徊，现在逐步进入复苏通道。目前新的应用方向包括先进封装中的蓝宝石载板和封装基板。手机、服务器等终端设备越来越轻薄，但芯片集成度却持续攀升，这就需要 3D 堆叠等新工艺来解决散热难题。而超薄硅片容易翘曲甚至破碎，用上机械强度更高、更耐磨损的蓝宝石载板，就像给精密仪器换上一副坚固外壳，大幅提升了良品率。到明年这一方案将在国内部分头部企业实现量产落地。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|